



Title of Change:	Capacity Expansion of Assembly and Test operations of ON Suzhou for D2PAK package to ON Seremban, Malaysia.																										
Proposed First Ship date:	25 January 2020																										
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com>																										
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.																										
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>																										
Change Part Identification:	Affected products will be identified by Marking code																										
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☒ Test Change ☐ Other _____																										
Change Sub-Category(s):																											
☒ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☒ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____																											
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia ON Suzhou, China		External Foundry/Subcon Sites: None																								
Description and Purpose:																											
This Product Change Notification is to announce that ON Semiconductor is expanding Assembly and Test Operations of ON Suzhou for D2PAK package to ON Seremban, Malaysia. No change on existing OPN. There will be two separate BOMs for ON Suzhou, China and ON Seremban, Malaysia.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change Description</th> <th colspan="2">After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assembly Site</td> <td>ON Suzhou</td> <td>ON Suzhou</td> <td>ON Seremban</td> </tr> <tr> <td>LeadFrame</td> <td>TSP</td> <td>TSP</td> <td>SDI</td> </tr> <tr> <td>Die Attach</td> <td>PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5</td> <td>PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5</td> <td>Pb95Sn5</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire</td> <td>Heraeus 99.99% Aluminium wire</td> <td>Heraeus 99.99% Aluminium wire</td> <td>Tanaka 99.99% Aluminum wire</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL</td> <td>CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL</td> <td>G700HF KTMC5900GMF01</td> </tr> </tbody> </table>				Before Change Description	After Change Description		Assembly Site	ON Suzhou	ON Suzhou	ON Seremban	LeadFrame	TSP	TSP	SDI	Die Attach	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	Pb95Sn5	Bond Wire	Heraeus 99.99% Aluminium wire	Heraeus 99.99% Aluminium wire	Tanaka 99.99% Aluminum wire	Mold Compound	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	G700HF KTMC5900GMF01
	Before Change Description	After Change Description																									
Assembly Site	ON Suzhou	ON Suzhou	ON Seremban																								
LeadFrame	TSP	TSP	SDI																								
Die Attach	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	Pb95Sn5																								
Bond Wire	Heraeus 99.99% Aluminium wire	Heraeus 99.99% Aluminium wire	Tanaka 99.99% Aluminum wire																								
Mold Compound	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	G700HF KTMC5900GMF01																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>From</th> <th>To</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Product marking change</td> <td>Ex-FCS Format</td> <td>ON Semiconductor format</td> </tr> </tbody> </table>				From	To	Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format																		
	From	To																									
Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format																									

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME : FQB12P20TM, FDB082N15A, HUF75639S3ST, FQB7N60TM, FCB290N80,
FFB20UP30DNTM, ISL9R18120S3ST, FDB2710, FQB5N90TM, FCB070N65S3

RMS: 56028, 56050, 56051, 56053, 56054, 55729, 55808, 56854, 56861, 56862
PACKAGE : D2PAK

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150/175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150/175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150/175°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C Ton=Toff = 2 min	8572 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150/175°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, 80% bias	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta= 121°C, 100% RH	96 hrs
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	-
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	-

Estimated date for qualification completion: 16 August 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FCB110N65F	FCB070N65S3
NTB082N65S3F	FCB070N65S3
FCB070N65S3	FCB070N65S3
FCB20N60FTM	FCB070N65S3
FCB36N60NTM	FCB070N65S3
FCB20N60TM	FCB070N65S3
FCB11N60TM	FCB290N80
FCB290N80	FCB290N80
FCB199N65S3	FCB290N80
FCB260N65S3	FCB290N80
FDB082N15A	FDB082N15A
FDB110N15A	FDB082N15A
FDB390N15A	FDB082N15A
FDB3502	FDB082N15A



FDB8444	FDB082N15A
FDB8447L	FDB082N15A
FDB120N10	FDB082N15A
FDB150N10	FDB082N15A
FDB088N08	FDB082N15A
FDB024N06	FDB2710
FDB031N08	FDB2710
FDB2614	FDB2710
FDB2710	FDB2710
FDB035N10A	FDB2710
FDB075N15A	FDB2710
FDB86135	FDB2710
HUF75345S3ST	FDB2710
HUF75545S3ST	FDB2710
HUF75645S3ST	FDB2710
HUFA75645S3S	FDB2710
FDB035AN06A0	FDB2710
FDB045AN08A0	FDB2710
FDB2532	FDB2710
FDB3632	FDB2710
FDB029N06	FDB2710
FDB060AN08A0	FDB2710
FDB050AN06A0	FDB2710
FDB047N10	FDB2710
FDB070AN06A0	FDB2710
FFB20UP20STM	FFB20UP30DNTM
FFB20UP30DNTM	FFB20UP30DNTM
IRFW630BTM-FP001	FQB12P20TM
FQB19N20CTM	FQB12P20TM
FQB44N10TM	FQB12P20TM
FQB19N20TM	FQB12P20TM
FQB19N20LTM	FQB12P20TM
FQB22P10TM	FQB12P20TM
FQB33N10TM	FQB12P20TM
FQB12P20TM	FQB12P20TM
FQB9P25TM	FQB12P20TM
FQB33N10LTM	FQB12P20TM
FQB27P06TM	FQB12P20TM
FQB50N06LTM	FQB12P20TM
FQB50N06TM	FQB12P20TM
FQB7P20TM	FQB12P20TM
FQB30N06LTM	FQB12P20TM



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22746X

Issue Date: 25 July 2019

FQB11P06TM	FQB12P20TM
FQB8P10TM	FQB12P20TM
FDB86102LZ	FQB12P20TM
FDB14N30TM	FQB12P20TM
FDB38N30U	FQB5N90TM
FQB47P06TM-AM002	FQB5N90TM
FDB44N25TM	FQB5N90TM
FDB52N20TM	FQB5N90TM
FQB34N20TM-AM002	FQB5N90TM
FQB34N20LTM	FQB5N90TM
FQB8N90CTM	FQB5N90TM
FDB15N50	FQB5N90TM
FQB34P10TM	FQB5N90TM
FQB55N10TM	FQB5N90TM
FQB6N80TM	FQB5N90TM
FQB5N90TM	FQB5N90TM
FDB28N30TM	FQB5N90TM
FDB20N50F	FQB5N90TM
FDB33N25TM	FQB5N90TM
FQB10N50CFM-WS	FQB5N90TM
FQB8N60CTM	FQB7N60TM
FQB11N40CTM	FQB7N60TM
FQB1P50TM	FQB7N60TM
FQB8N60CTM-WS	FQB7N60TM
FQB9N50CTM	FQB7N60TM
FQB5N50CTM	FQB7N60TM
FQB5N60CTM-WS	FQB7N60TM
FQB6N40CTM	FQB7N60TM
FQB7N60TM	FQB7N60TM
FQB7N60TM-WS	FQB7N60TM
FQB4N80TM	FQB7N60TM
FDB12N50FTM-WS	FQB7N60TM
FDB12N50TM	FQB7N60TM
HUF75639S3ST	HUF75639S3ST
HUF76439S3ST	HUF75639S3ST
HUF76639S3ST	HUF75639S3ST
HUF75631S3ST	HUF75639S3ST
HUF76429S3ST	HUF75639S3ST
FDB2552	HUF75639S3ST
FDB3652	HUF75639S3ST
FDB16AN08A0	HUF75639S3ST
FDB2572	HUF75639S3ST



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22746X

Issue Date: 25 July 2019

FDB13AN06A0	HUF75639S3ST
FDB3682	HUF75639S3ST
ISL9R1560S3ST	ISL9R18120S3ST
ISL9R18120S3ST	ISL9R18120S3ST
ISL9R860S3ST	ISL9R18120S3ST

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22746X

発行日 : 25 July 2019

変更件名:	ON 蘇州の D2PAK パッケージの組立および検査 オペレーションの能力をオン・セレンバン(マレーシア)に拡大																										
初回出荷予定日:	25 January 2020																										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com> にお問い合わせください。																										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。																										
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																										
変更部品の識別:	影響を受ける製品はマーキングコードで識別されます。																										
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☒ 試験の変更 ☐ その他 _____																										
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☒ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____																										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia ON Suzhou, China	外部製造工場 / 下請業者拠点: None																									
説明および目的: 本製品変更通知は、オン・セミコンダクターが、ON 蘇州における D2PAK パッケージの組立および検査 オペレーションの能力を、オン・セレンバン(マレーシア)に拡張することをお知らせするものです。 既存の製品(OPN)に加えられる変更はありません。ON 蘇州(中国)とオン・セレンバン(マレーシア)に別々の材料(BOM)が存在することになります。																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th colspan="2">変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立拠点</td> <td>ON 蘇州</td> <td>ON 蘇州</td> <td>ON セレンバン</td> </tr> <tr> <td>リードフレーム</td> <td>TSP</td> <td>TSP</td> <td>SDI</td> </tr> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5</td> <td>PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5</td> <td>Pb95Sn5</td> </tr> <tr> <td>ボンドワイヤー</td> <td>Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー</td> <td>Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー</td> <td>Tanaka 99.99% アルミニウムワイヤー</td> </tr> <tr> <td>モールド・コンパウンド</td> <td>CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL</td> <td>CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL</td> <td>G700HF KTMCS900GMF01</td> </tr> </tbody> </table>				変更前の表記	変更後の表記		組立拠点	ON 蘇州	ON 蘇州	ON セレンバン	リードフレーム	TSP	TSP	SDI	ダイ接着剤	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	Pb95Sn5	ボンドワイヤー	Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー	Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー	Tanaka 99.99% アルミニウムワイヤー	モールド・コンパウンド	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	G700HF KTMCS900GMF01
	変更前の表記	変更後の表記																									
組立拠点	ON 蘇州	ON 蘇州	ON セレンバン																								
リードフレーム	TSP	TSP	SDI																								
ダイ接着剤	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	PB92.5,SN5AG2.5 PB93.5SN5AG1.5	Pb95Sn5																								
ボンドワイヤー	Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー	Heraeus 99.99% アルミニウムワイヤー	Tanaka 99.99% アルミニウムワイヤー																								
モールド・コンパウンド	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	CEL8240HF10FC EME6600CS SG8200DL	G700HF KTMCS900GMF01																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品表示変更</td> <td>旧フェアチャイルドフォーマット</td> <td>オン・セミコンダクター フォーマット</td> </tr> </tbody> </table>				変更前	変更後	製品表示変更	旧フェアチャイルドフォーマット	オン・セミコンダクター フォーマット																		
	変更前	変更後																									
製品表示変更	旧フェアチャイルドフォーマット	オン・セミコンダクター フォーマット																									



認定計画:

デバイス名 : FQB12P20TM, FDB082N15A, HUF75639S3ST, FQB7N60TM, FCB290N80,
FFB20UP30DNTM, ISL9R18120S3ST, FDB2710, FQB5N90TM, FCB070N65S3

RMS : 56028, 56050, 56051, 56053, 56054, 55729, 55808, 56854, 56861, 56862
パッケージ : D2PAK

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150/175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150/175°C, 100% max rated V _{gss}	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150/175°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C Ton=Toff = 2 min	8572 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150/175°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, 80% bias	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta= 121°C, 100% RH	96 hrs
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	-
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	-

認定完了予定日 : 16 August 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FCB110N65F	FCB070N65S3
NTB082N65S3F	FCB070N65S3
FCB070N65S3	FCB070N65S3
FCB20N60FTM	FCB070N65S3
FCB36N60NTM	FCB070N65S3
FCB20N60TM	FCB070N65S3
FCB11N60TM	FCB290N80
FCB290N80	FCB290N80
FCB199N65S3	FCB290N80
FCB260N65S3	FCB290N80
FDB082N15A	FDB082N15A
FDB110N15A	FDB082N15A
FDB390N15A	FDB082N15A



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22746X

発行日 : 25 July 2019

FDB3502	FDB082N15A
FDB8444	FDB082N15A
FDB8447L	FDB082N15A
FDB120N10	FDB082N15A
FDB150N10	FDB082N15A
FDB088N08	FDB082N15A
FDB024N06	FDB2710
FDB031N08	FDB2710
FDB2614	FDB2710
FDB2710	FDB2710
FDB035N10A	FDB2710
FDB075N15A	FDB2710
FDB86135	FDB2710
HUF75345S3ST	FDB2710
HUF75545S3ST	FDB2710
HUF75645S3ST	FDB2710
HUFA75645S3S	FDB2710
FDB035AN06A0	FDB2710
FDB045AN08A0	FDB2710
FDB2532	FDB2710
FDB3632	FDB2710
FDB029N06	FDB2710
FDB060AN08A0	FDB2710
FDB050AN06A0	FDB2710
FDB047N10	FDB2710
FDB070AN06A0	FDB2710
FFB20UP20STM	FFB20UP30DNTM
FFB20UP30DNTM	FFB20UP30DNTM
IRFW630BTM-FP001	FQB12P20TM
FQB19N20CTM	FQB12P20TM
FQB44N10TM	FQB12P20TM
FQB19N20TM	FQB12P20TM
FQB19N20LTM	FQB12P20TM
FQB22P10TM	FQB12P20TM
FQB33N10TM	FQB12P20TM
FQB12P20TM	FQB12P20TM
FQB9P25TM	FQB12P20TM
FQB33N10LTM	FQB12P20TM
FQB27P06TM	FQB12P20TM
FQB50N06LTM	FQB12P20TM
FQB50N06TM	FQB12P20TM
FQB7P20TM	FQB12P20TM



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN22746X

発行日 : 25 July 2019

FQB30N06LTM	FQB12P20TM
FQB11P06TM	FQB12P20TM
FQB8P10TM	FQB12P20TM
FDB86102LZ	FQB12P20TM
FDB14N30TM	FQB12P20TM
FDB38N30U	FQB5N90TM
FQB47P06TM-AM002	FQB5N90TM
FDB44N25TM	FQB5N90TM
FDB52N20TM	FQB5N90TM
FQB34N20TM-AM002	FQB5N90TM
FQB34N20LTM	FQB5N90TM
FQB8N90CTM	FQB5N90TM
FDB15N50	FQB5N90TM
FQB34P10TM	FQB5N90TM
FQB55N10TM	FQB5N90TM
FQB6N80TM	FQB5N90TM
FQB5N90TM	FQB5N90TM
FDB28N30TM	FQB5N90TM
FDB20N50F	FQB5N90TM
FDB33N25TM	FQB5N90TM
FQB10N50CTM-WS	FQB5N90TM
FQB8N60CTM	FQB7N60TM
FQB11N40CTM	FQB7N60TM
FQB1P50TM	FQB7N60TM
FQB8N60CTM-WS	FQB7N60TM
FQB9N50CTM	FQB7N60TM
FQB5N50CTM	FQB7N60TM
FQB5N60CTM-WS	FQB7N60TM
FQB6N40CTM	FQB7N60TM
FQB7N60TM	FQB7N60TM
FQB7N60TM-WS	FQB7N60TM
FQB4N80TM	FQB7N60TM
FDB12N50FTM-WS	FQB7N60TM
FDB12N50TM	FQB7N60TM
HUF75639S3ST	HUF75639S3ST
HUF76439S3ST	HUF75639S3ST
HUF76639S3ST	HUF75639S3ST
HUF75631S3ST	HUF75639S3ST
HUF76429S3ST	HUF75639S3ST
FDB2552	HUF75639S3ST
FDB3652	HUF75639S3ST
FDB16AN08A0	HUF75639S3ST



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22746X

発行日 : 25 July 2019

FDB2572	HUF75639S3ST
FDB13AN06A0	HUF75639S3ST
FDB3682	HUF75639S3ST
ISL9R1560S3ST	ISL9R18120S3ST
ISL9R18120S3ST	ISL9R18120S3ST
ISL9R860S3ST	ISL9R18120S3ST